TSMC представила новые разработки, которые позволят создать более быстрые и мощные процессоры. Компания анонсировала разработку технологии «System on Wafer-X», которая позволит объединять до 16 больших вычислительных чипов, а также чипы памяти и оптические соединения. Это обеспечит значительное повышение производительности, необходимое для приложений в области искусственного интеллекта (ИИ)

TSMC также сообщила о планах построить два новых завода в Аризоне, которые будут производить чипы, а также создать исследовательский центр и фабрики по упаковке чипов. Это дополнит существующие мощности компании в США, увеличив ее производственные возможности.

Кроме того, компания представила новую технологию под названием A14, которая будет доступна в 2028 году, обещает чипы, которые будут на 15% быстрее при тех же уровнях потребления энергии, или на 30% более энергоэффективными при той же скорости, что и чипы N2, которые начнут производиться в этом году.

Все права защищены